

COB-Chip on Board

晶片直接植於電路板，是積體電路封裝的一種方式。

COB作法是將裸晶片直接黏在電路板或基板上，並結合三項基本製程：

- (1) 晶片黏著
- (2) 導線連接
- (3) 應用封膠技術，有效將IC製造過程中的封裝與測試步驟轉移到電路板組裝階段。

目前IC半導體晶片封裝製程大多使用移轉模注成形膠餅材料(Transfer Molding Compound)

作為封裝材料，利用特定之模具將膠材經預熱後注入含IC晶片導線架之模具內，而達成封裝之目的。然隨著半導體晶片薄型化、高腳數、與模組化的發展趨勢，特別是近年來除了原有之Hybrid元件封裝用途外，

COB、TAB、PBGA、及Flip Chip等構裝技術之發展，

已逐漸選用液狀封裝材料(Liquid Encapsulant)。

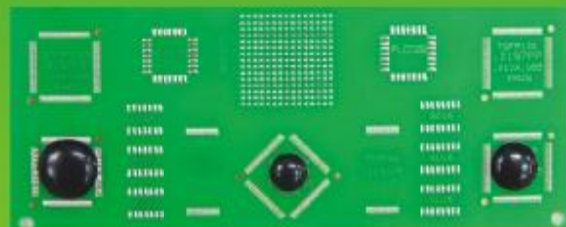
透過分配器將液狀封裝材注於半導體晶片上，達到保護功能。



Glob-Top

產品特色

- 快速固化 120°C*40min
- 成型性佳
- 對FR4,FR5,BT,FPC接著力佳,可達基材破壞強度
- 表面平整度高
- 通過信賴性測試,冷熱循環,冷熱衝擊,高溫高溼,高溫烹煮



產品編號	黏度值 ,cps	硬化條件	硬度	吸水率 %	玻璃轉換溫度 Tg, °C	體積電阻 Ohm-cm	破壞電壓 KV/mm	熱傳導係數 W/m.k	熱膨脹係數 <Tg, ppm	耐熱溫度 °C
JC349-2 (低鹵素)	106,700 138,000	120°C * 40min	ShoreD 90	2.06	131	4.5*10 ¹⁵	3	0.3	47	-40 ~ 120
JC349-10 (低鹵素)	80,763 91,945	120°C * 40min	ShoreD 89	2.2	128	4.5*10 ¹⁶	3	0.3	40	-40 ~ 120

Dam&Fill

產品特色

- 低溫固化120°C*40min
- Dam膠與Fill膠相容性佳
- 對FR4,FR5,BT,FPC接著力佳,可達基材破壞強度
- 作業性佳
- 通過信賴性測試,冷熱循環,冷熱衝擊,高溫高溼,高溫烹煮



產品編號	黏度值 ,cps	硬化條件	硬度	吸水率 %	玻璃轉換溫度 Tg, °C	體積電阻 Ohm-cm	破壞電壓 KV/mm	熱傳導係數 W/m.k	熱膨脹係數 <Tg, ppm	耐熱溫度 °C
JC349-8 (低鹵素)	190,000 575,000	120°C*40min	ShoreD 90	2.06	131	4.5*10 ¹⁵	3	0.3	47	-40 ~ 120
JC349-10 (低鹵素)	80,763 91,945	120°C*40min	ShoreD 89	2.2	128	4.5*10 ¹⁵	3	0.3	40	-40 ~ 120

Encapsulate by Printing

產品特色

- 低溫固化120°C*40min
- 印刷性佳
- 對FR4,FR5,BT,FPC接著力佳,可達基材破壞強度
- 成型性佳
- 通過信賴性測試,冷熱循環,冷熱衝擊,高溫高溼,高溫烹煮等



產品編號	黏度值 ,cps	硬化條件	硬度	吸水率 %	玻璃轉換溫度 Tg, °C	體積電阻 Ohm-cm	破壞電壓 KV/mm	熱傳導係數 W/m.k	熱膨脹係數 <Tg, ppm	耐熱溫度 °C
JC349-33 (低鹵素)	71,000~107,000 90,000~137,000	120°C*40min	ShoreD 88	1.9	130	4.5*10 ¹⁵	3	0.3	37	-40 ~ 120

永寬化學股份有限公司 EVERWIDE CHEMICAL CO.,LTD.

[Http://www.everwide.com.tw](http://www.everwide.com.tw)

總公司 雲林縣斗六市斗工六路36號
No.36, Dougong 6th Rd., Douliou City, Yunlin County
64069, Taiwan
TEL : +886-5-5574717 FAX : +886-5-5574719
E-mail : sales@everwide.com.tw

分公司 桃園縣中壢市中山東路一段223巷89弄7號5樓
5F., No.7, Alley 89, Sec. 1, Jhongshan E. Rd., Jhongli City,
Taoyuan County 32087, Taiwan
TEL : +886-3-4342833 FAX : +886-3-4342835

授權經銷商 Distributors /